# E3-4 Analog Elektronik (AEL)

Komponenter, Kredsløb og Analyse AEL19

Jan Hvolgaard Mikkelsen, Ole Kiel Jensen og Sofus Birkedal Nielsen {jhm, okj, sbn}@es.aau.dk

Aalborg Universitet



# Kursusoversigt



Kursusgang	Emne	Forelæser
AEL11	Højfrekvens respons	SBN
AEL12	LF design eksempel	JHM
AEL13	Harmonisk forvrængning	JHM
AEL14	Flertrinsforstærker	JHM
AEL15	Effektforstærker – I	JHM
AEL16	Diff. forstærker/strømspejl	SBN
AEL17	Opamp – Idelle	SBN
AEL18	Opamp – ikke idelle	SBN
AEL19	Effektforstærker – II	JHM
AEL20	Effektforstærker – III	JHM

### **Agenda**



- Lidt opsamling fra PA I (AEL15)
  - Udgangstrin
  - Forvrængning forskellige typer
- Termiske effekter
  - Termisk equivalent kredsløb
  - Design af køling
- Safe Operating Area (SOA) for en BJT
- Termisk stabilitet
- Termisk run-away
- Design af R<sub>E</sub>
- Klasse AB bias
  - o V<sub>BE</sub>-Multiplier

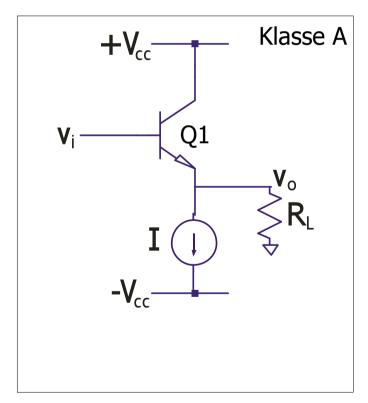
Lidt til opgaverne

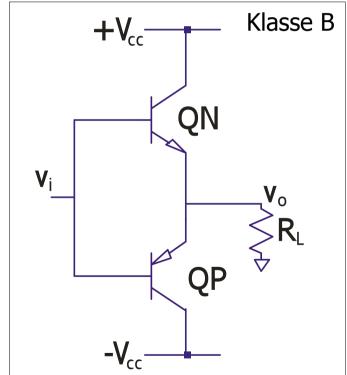
Vi kigger fortsat "kun" på selve udgangstrinnet

### **Opsamling - udgangstrinnet**



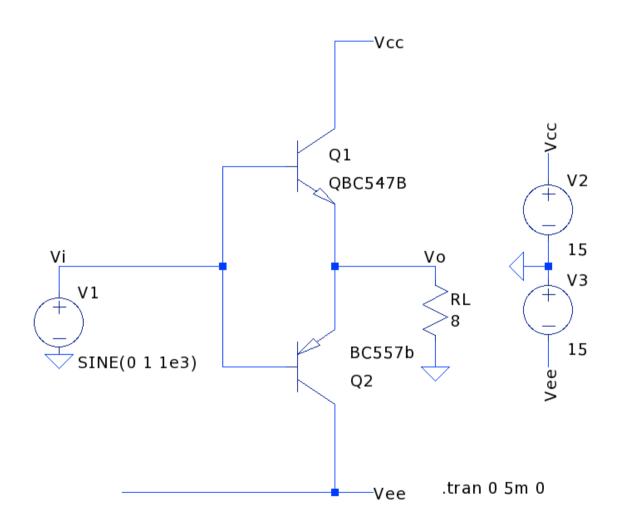
- Som vi har set, så findes der et væld af forskellige "typer" af effektforstærkere, og vores fokus er på klasse A, B, og AB
- Klassefikationen sker på baggrund af formen af udgangssignalet for en given forstærker strømvinklen
- Klassificeringen sker indirekte udfra transistorens arbejdspunkt





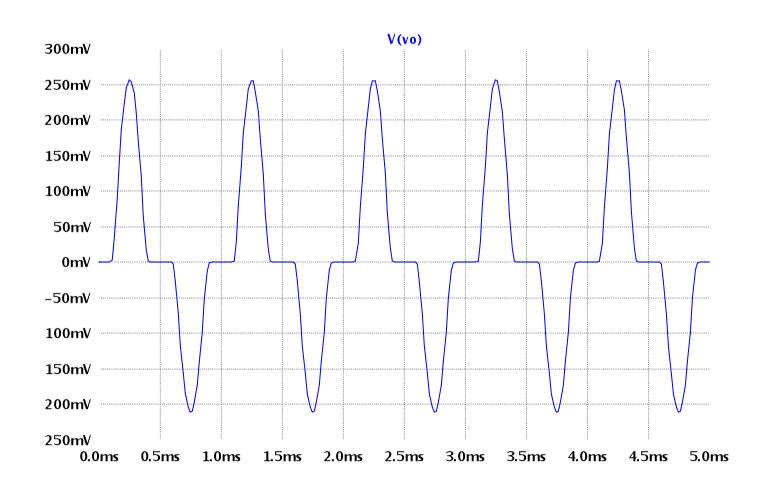


### LTspice: simpel klasse B



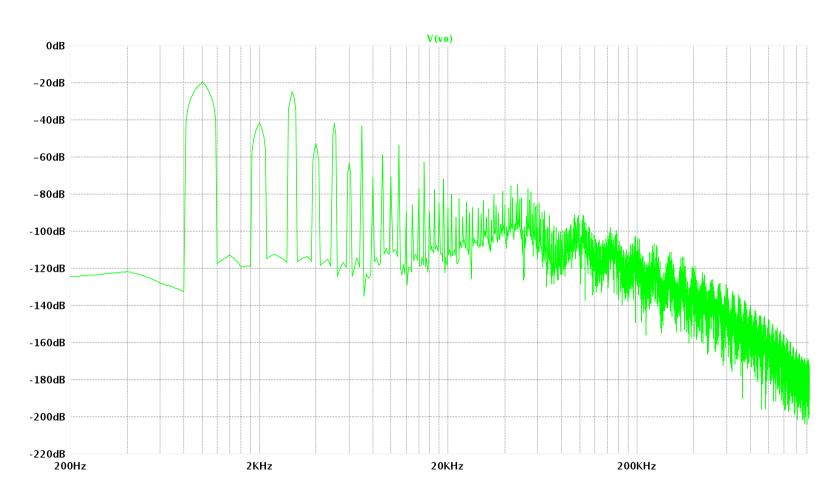


#### **Cross-Over forvrængning i simpel klasse B**





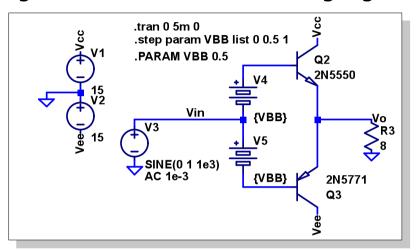
### Forvrængning i simpel klasse B

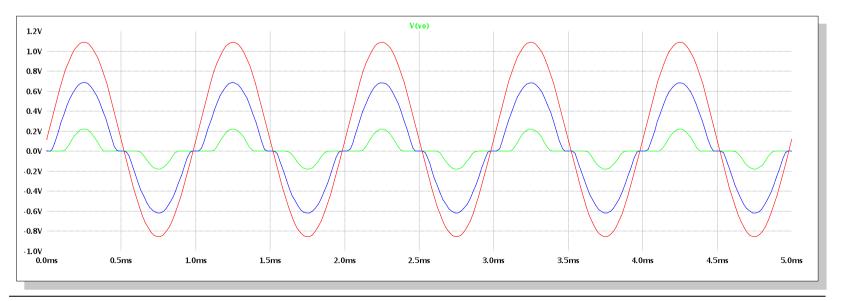


# **Opsamling – Klasse B (AB) bias**



• Eksempler på signalerne for en klasse AB udgang

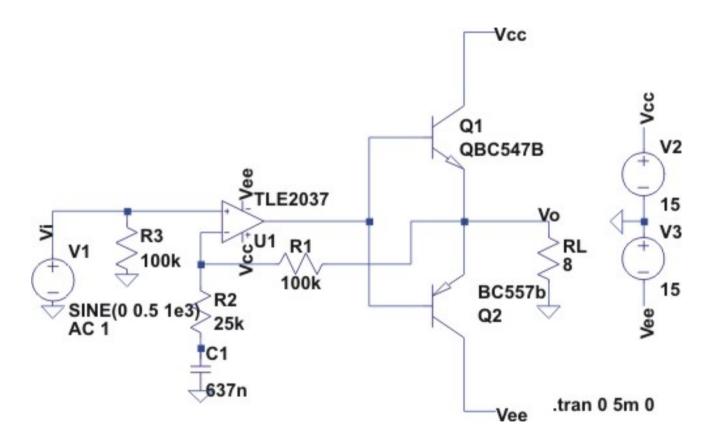






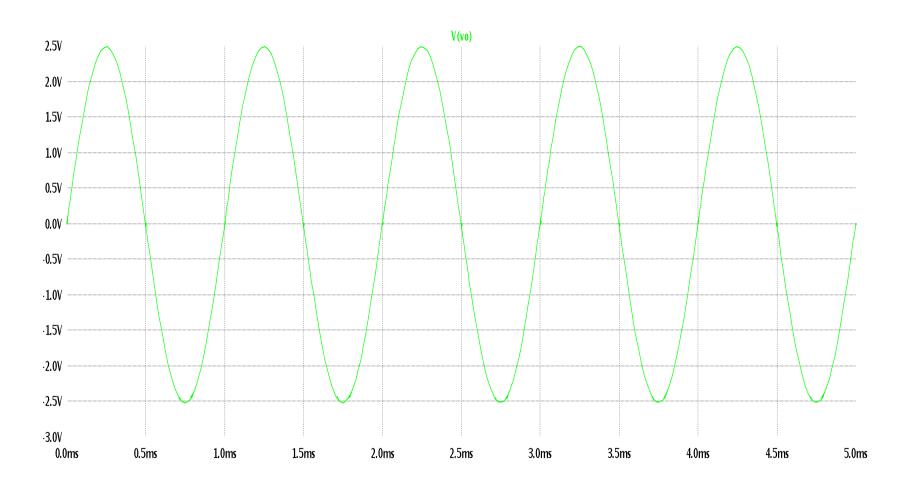
#### LTspice: Tilbagekoblet klasse B

100% DC feedback



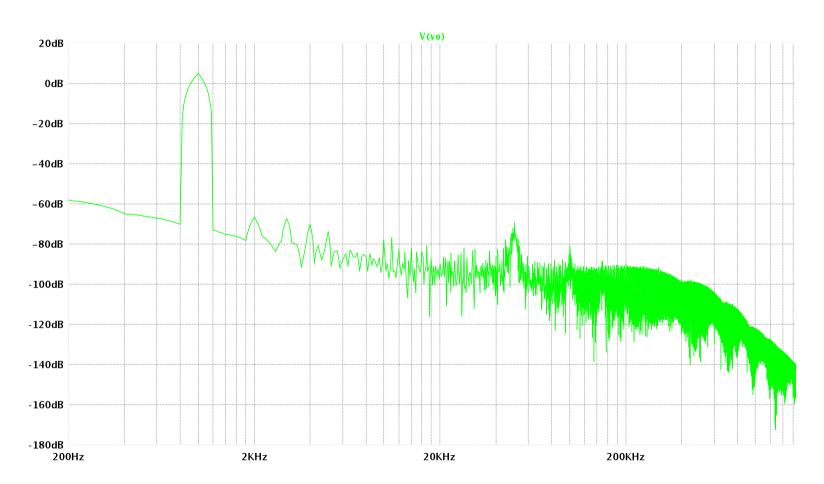


#### Tilbagekobling fjerne cross-over i simpel klasse B





### Forvrængning i tilbagekoblet klasse B



### **Opsamling - forvrængning**



#### "Opgave 1" fra AEL15

•  $R_o$  er cirka  $1/g_{mQ1}$  og samtidig er  $g_m$  en funktion af  $I_C$  .tran 10m .op

10

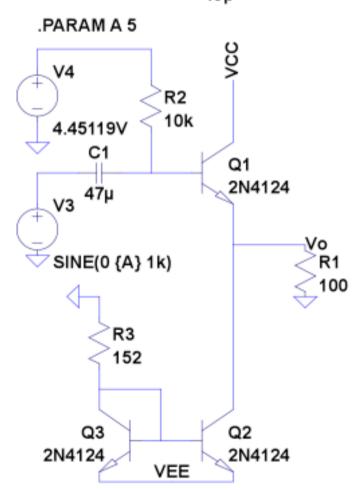
V2

当10

 Som et resultat oplever vi en ændring i "damping faktor"

$$DF = \frac{R_L}{R_o}$$

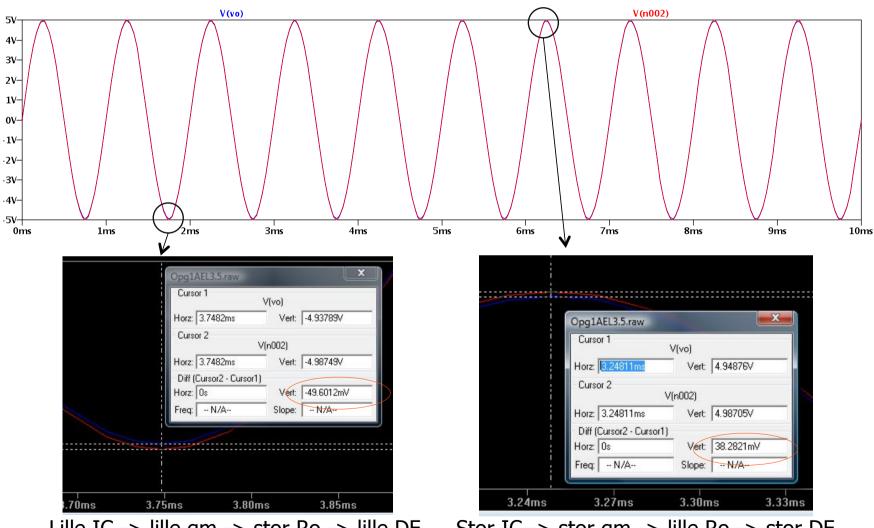
- Med Thevenin i baghovedet bliver "problemet" klart
- Vores x1 udgang er ikke konstant x1
- Vi får med andre ord en forstærkning der svinger som funktion af den øjeblikkelige udstyring af udgangen



### **Opsamling - forvrængning**



• Vi kan se effekten af at arbejde med store signaler ...



Lille IC -> lille gm -> stor Ro -> lille DF

Stor IC -> stor gm -> lille Ro -> stor DF

Jan H. Mikkelsen

### Forvrængning – Beta droop



- En ting vi ikke kom ind på sidst er sammenhængen mellem  $\beta$  og  $I_{\text{C}}$  for en BJT
- Beta droop (værrer for stigende I<sub>c</sub>)

CC:  $r_{in} = r_{\pi} + \beta \cdot R_L$ 

- Nært beslægtet med Damping Factor, men beta droop giver anledning til forvrængning i drivertrinnet
- Hvis "per-device I<sub>C</sub>" kan reduceres, så vil effekten af beta droop også blive reduceret
- Derfor kobles BJT'er ofte parallelt
- Da beta for en FET i princippet er uendelig stor til enhver tid, så lider en FET udgang ikke af dette
- P₀ større -> ☺
- R₁ laver -> ⊗

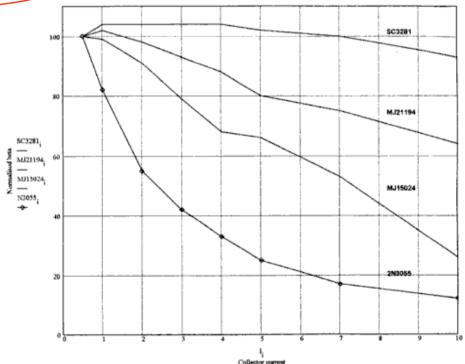


Figure 5.19

Power transistor beta falls as collector current Increases. Beta is normalised to 100 at 0.5 A (from manufacturers' data sheets)

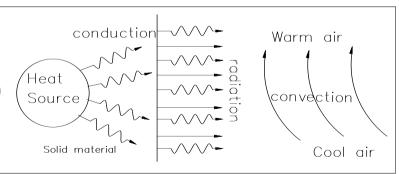
### **Termiske hensyn**



- Når de forskellige effektforstærkertyper betragtes ses det tydeligt, at en betydelig del af den leverede effekt bliver afsat i udgangstrinnet selv
- Da den afsatte effekt ikke bare forsvinder op i den blå luft må den nødvendigvis blive afsat i form af varme
- Vores designs skal være i stand til at sikre at vi ikke ender op med så høje temperaturer at transistorerne brænder af
- Det stiller krav til både det elektriske og det termiske design
- Yderligere en elektrisk-termisk dualitet gør at vi skal sikre både elektrisk og termisk stabilitet i vores kredsløb

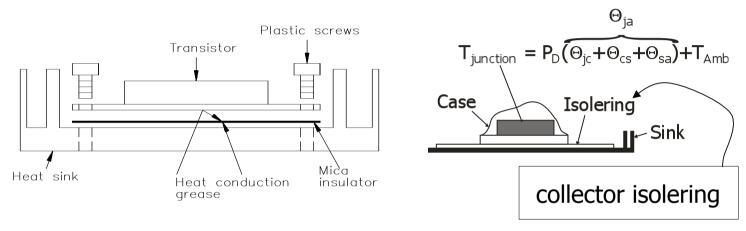


- Forstærkere har en nyttevirkning der ofte ligger langt under 100%
- Effekttransistoren er her en af "storforbrugerene" af effekt
- Forbruget sker i form af en varmeforøgelse internt i transistoren
- Varmestigningen sker primært i collector overgangen
- For at sikre korrekt operation af transistoren skal denne temperaturstigning begrænses til et acceptabelt niveau
- Den maksimalt tilladelige collector junction temperatur for Silicium baserede power transistorer ligger omkring 150 – 200°C
- Hvorledes kan vi håndtere den del af den afsatte effekt der ikke går til loaden?
  - Conduction (heat sinks)
  - Radiation (passende overflader)
  - Convection (fans)





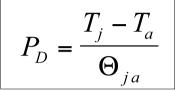
- For at kunne regne lidt på de termiske forhold opstiller vi et elektrisk equivalent for systemet
- Systemet inkludere her både transistor, pakke samt køleplade

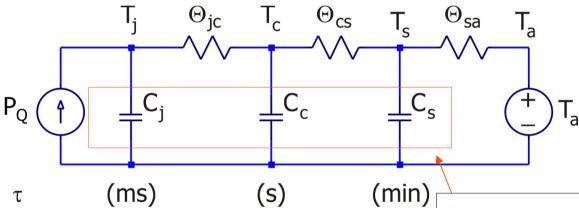


- P, Θ og T svare til strøm, modstand og spænding
- Databladet specificere normalt en "maximum operating junction temperature", junction-to-case termisk modstand  $(\Theta_{jc})$  samt en case-to-ambient termisk modstand  $(\Theta_{ca})$  .. jo mindre jo bedre!
- Enheden for Θ er grader pr. Watt
- For at forbedre varmeafledningsegenskaberne monteres en effektkomponent ofte på en køleplade (heat sink)



- Vi kan nu betragte to former for effekt når vi ser på de termiske forhold for en effekttransistor
- Modtaget elektrisk effekt: P<sub>Q</sub>
- Afgivet termisk effekt: P<sub>D</sub>





Ligevægt:  $P_Q = P_D \rightarrow T_j$  er konstant

Opvarmning:  $P_O > P_D \rightarrow T_i$  stiger

Afkøling:  $P_O < P_D \rightarrow T_i$  falder

Vigtige ved pulsede systemer

Krav:

$$T_j < T_{j,max}$$
 absolut  
 $T_s - T_a \le 40$ °C (65°C)



- Vi har nu fået defineret et elektrisk equivalent for de termiske effekter i effekttransistoren incl. køleplader
- Termisk modstand: Θ = R<sub>th</sub> [°K/W]
- Termisk "Ohms lov":  $T_j T_a = P_D \cdot \Theta_{ja}$ , hvor  $\Theta_{ja} = \Theta_{jc} + \Theta_{cs} + \Theta_{sa}$
- Beregning af køleflade:

$$\Theta_{sa} = \frac{T_j - T_{a,\text{max}}}{P_{D,\text{max}}} - \Theta_{jc} - \Theta_{cs}$$

Evt. opgivet i datablad!!

$$\Theta_{sa} = \frac{\rho \cdot t}{A}$$

ρ: termisk resistivitet i (°C\*m)/W

t: materialetykkelse

A: materiale areal

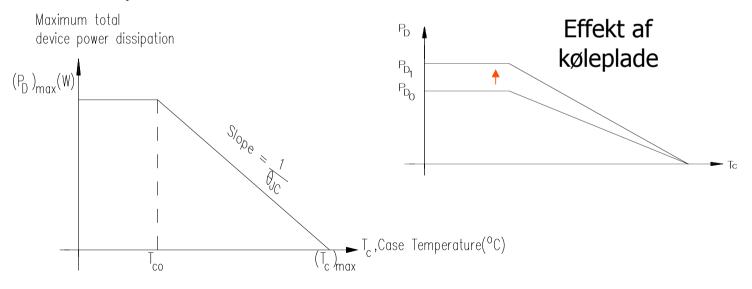


- For at optimere de termiske egenskaber (minimere  $\Theta_{jc}$ ) for transistoren er collectoren oftest forbundet til case'en
- For at undgå kortslutninger er det vigtigt at case'en ikke bliver sluttet til køleelementet rent elektrisk
- Til at sikre "termisk kortslutning" og elektrisk afbrydelse benyttes forskellige isolatorer
- Husk at både case og monteringsskruer skal isoleres (+ pasta)

Materiale	Termisk	Elektrisk	Θ	Øvrigt
Mica	God	Ok	0.75 – 1.0	Skrøbelig
Kapton	God	Ok	0.9 – 1.5	Robust
Alu. oxid	Super	Ok	0.4	Skrøbelig
Beryllium	Super	Ok	0.25	Giftig
Sil-pads	God	Ok	1.0 – 1-5	Praktisk



- Det er ikke altid muligt direkte at finde data for  $\Theta_{\rm jc}$  og  $\Theta_{\rm cs}$  i databladene
- I stedet har fabrikanterne en "power de-rating curve" med
- Her varmes case'en i stedet op og så angives hvor stor en elektrisk effekt der må blive tilført transistoren (afsat i denne)
- For en given afsat effekt kan vi aflæse hvor varm case'en maksimalt må blive
- Vi skal så sørge for at denne temperatur ikke bliver overskredet .. evt. vha. køleplader



### **Safe Operating Area (SOA)**



 Ud over at inkludere en "power de-rating" kurve i databladet, så specificere fabrikanter normalt også et SOA plot

• SOA plottet indikere hvilke områder i i<sub>C</sub>-v<sub>CE</sub> transistoren skal befinde

sig i såfremt sikker og pålidelig operation ønskes

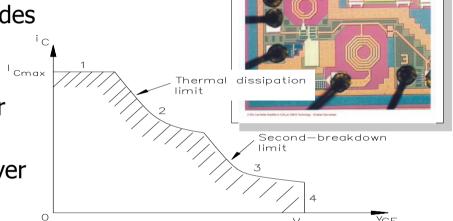
1. Maksimalt tilladelig i<sub>C</sub>. Overskrides denne kan bondwires smelte

2. Termisk grænse hvor i<sub>C</sub>-v<sub>CE</sub> relationen giver P<sub>D,max</sub>. Dette er typisk angivet ved 25°C

3. Pga. non-uniform strøm hen over emitter-base junctionen opstår termiske hot-spots der kan resultere i termisk run-away

4. Collector-emitter breakdown. Overstiger  $v_{CE}$  værdien for  $V_{CE0}$  risikeres avalanche breakdown

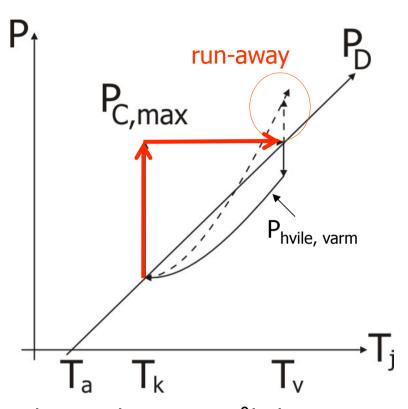
 For pulsede signaler kan transistoren tåle noget mere



Plottes karakteristikken i et dobbelt-log koordinatsystem består SOA kurverne af rette linier istedet



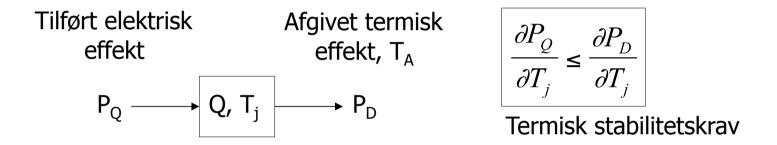
- Termisk operationsforløb
- Et kraftigt signal tilsluttes og køre nogen tid hvorefter det fjernes igen
- Udgangstransistorene er nu meget varme og er den "varme" hvileeffekt større end afkølingseffekten opstår termisk run-away
- Løsningemuligheder:
- Bedre kølingen (stejlere P<sub>D</sub>)
- Tilpasse P<sub>hvile, varm</sub> kurven så en stabil cyklus resultere



- To (i hvert fald) kredsløbsmæssige hensyn kan tages således at termisk run-away kan undgås
- R<sub>F</sub> modstand indføres
- V<sub>BE</sub>-multiplier kobles til udgangstransistorene



- Selv med alverdens køleplader koblet på en transistor vil der stadig være en risiko for termisk run-away
- Den elektriske analogi vi netop har 'udviklet' for de termiske effekter ...
   kan den bruges til noget fornuftigt i denne sammenhæng?



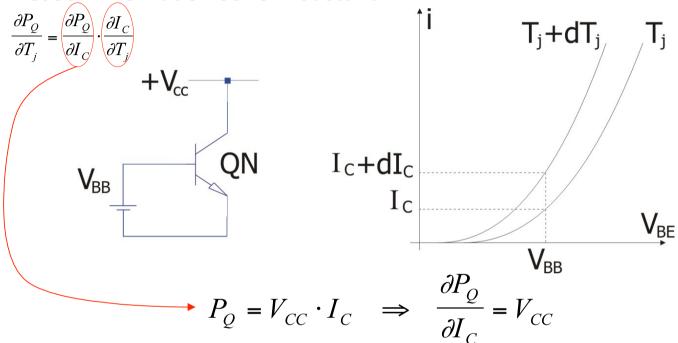
$$P_D = \frac{T_j - T_a}{\Theta_{ja}} \implies \frac{\partial P_D}{\partial T_j} = \frac{1}{\Theta_{ja}}$$

Ændringen i  $P_O(\partial P_O)$  stammer fra ændringen i  $T_i(\partial T_i)$ :

$$\frac{\partial P_{Q}}{\partial T_{j}} = \frac{\partial P_{Q}}{\partial I_{C}} \cdot \frac{\partial I_{C}}{\partial T_{j}}$$



Case 1: BJT uden serie-modstand



 $dI_C/dT_j$  for konstant  $V_{BE}$  søges. Vi løser dette ved partiel differentiation af  $V_{BE}$ = $f(I_C, T_i)$ 

$$dV_{BE} = \frac{\partial V_{BE}}{\partial I_{C}} \bigg|_{T_{j} \sim konst.} \cdot dI_{C} + \frac{\partial V_{BE}}{\partial T_{j}} \bigg|_{I_{C} \sim konst.} \cdot dT_{j} = \frac{1}{g_{m}} \cdot dI_{C} + K \cdot dT_{j}$$



Case 1: BJT uden serie-modstand

$$dV_{BE} = 0 \implies \frac{dI_C}{dT_j} = -g_m \cdot K = \frac{I_C}{V_T} \cdot 2mV \qquad \frac{dI_C}{I_C \cdot dT_j} = \frac{2mV}{V_T} \approx 0.13$$

Stabilitet for:

$$\frac{dP_Q}{dT_j} = \frac{dP_Q}{dI_C} \cdot \frac{dI_C}{dT_j} = V_{CC} \cdot (-g_m \cdot K) \le \frac{1}{\Theta_{ja}} \qquad I_C \le \frac{V_T}{-K \cdot V_{CC} \cdot \Theta_{ja}}$$

$$I_C \leq \frac{V_T}{-K \cdot V_{CC} \cdot \Theta_{ja}}$$

Eksempel med BC547b:

$$V_{CC} = 15V$$
,  $\Theta_{ja} = 250$ °C/W, og  $V_T = 26$ mV

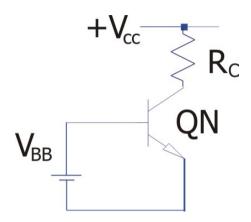
$$I_C \le \frac{V_T}{-K \cdot V_{CC} \cdot \Theta_{ja}} \le \frac{26mV}{2\frac{mV}{{}^oC} \cdot 15V \cdot 250\frac{{}^oC}{W}} \le 3.47mA$$



Case 2: BJT med serie-modstand i collectoren

$$P_Q = V_{CE} \cdot I_C = (V_{CC} - I_C \cdot R_C) \cdot I_C$$

$$\left| \frac{dP_Q}{dT_j} = \frac{dP_Q}{dI_C} \cdot \frac{dI_C}{dT_j} = \left( V_{CC} - 2 \cdot I_C \cdot R_C \right) \cdot \frac{dI_C}{dT_j} \right|$$



V<sub>BF</sub> er stadig konstant og vi får igen:

$$dV_{BE} = 0 \implies \frac{dI_C}{dT_j} = -g_m \cdot K = \frac{I_C}{V_T} \cdot 2mV$$

Stabilitet opnåes for:

$$\frac{dP_Q}{dT_j} \le \frac{dP_D}{dT_j} = \frac{1}{\Theta_{ja}} \implies (V_{CC} - 2 \cdot I_C \cdot R_C) \cdot (-g_m \cdot K) \le \frac{1}{\Theta_{ja}}$$



Case 2: BJT med serie-modstand i collectoren

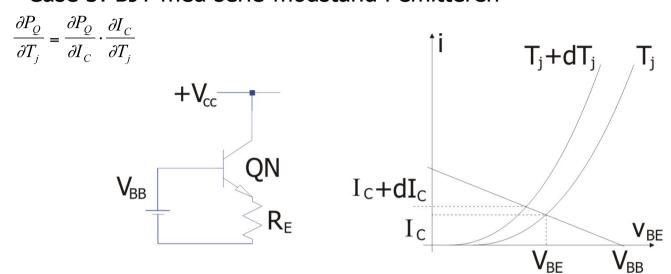
$$-V_{CC}\frac{I_{C}}{V_{T}}\cdot K+2\cdot I_{C}\cdot R_{C}\cdot \frac{I_{C}}{V_{T}}\cdot K\leq \frac{1}{\Theta_{ja}}$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad$$

Jan H. Mikkelsen



• Case 3: BJT med serie-modstand i emitteren



 $R_E$  ændre både  $dP_O/dI_C$  og  $dI_C/dT_i$ :

$$\frac{dP_Q}{dI_C} = \frac{d(V_{CC} - I_C \cdot R_E) \cdot I_C}{dI_C} = V_{CC} - 2 \cdot I_C \cdot R_E$$

$$V_{BE} = V_{BB} - I_C \cdot R_E \implies dV_{BE} = -dI_C \cdot R_E$$



Case 3: BJT med serie-modstand i emitteren

$$dV_{BE} = \frac{1}{g_m} \cdot dI_C + K \cdot dT_j$$

Har vi fra tidligere ...

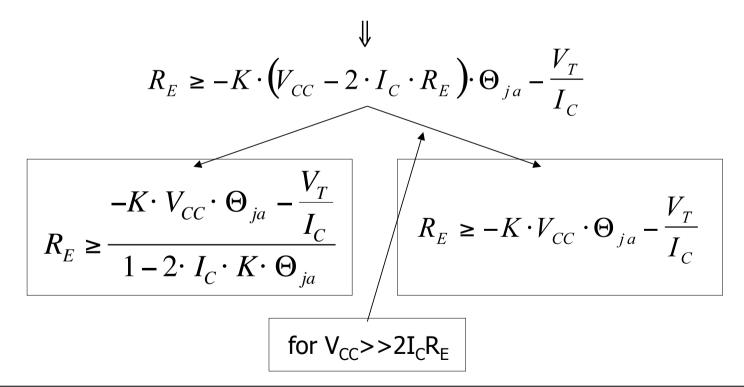
Stabilitet opnåes for:

$$\frac{dP_{Q}}{dT_{j}} \le \frac{dP_{D}}{dT_{j}} = \frac{1}{\Theta_{ja}} \implies \left(V_{CC} - 2 \cdot I_{C} \cdot R_{E}\right) \cdot \frac{-K}{\frac{1}{g_{m}} + R_{E}} \le \frac{1}{\Theta_{ja}}$$



Case 3: BJT med serie-modstand i emitteren

$$\frac{1}{g_m} = \frac{V_T}{I_C} \implies \frac{-(V_{CC} - 2 \cdot I_C \cdot R_E) \cdot K}{\frac{V_T}{I_C} + R_E} \le \frac{1}{\Theta_{ja}}$$





- Case 3: BJT med serie-modstand i emitteren
- Kigger vi igen på eksemplet med BC547b transistoren får vi følgende værdier for  $R_E$  (husk at  $I_{C,max}$  uden  $R_E$  var 3.47mA):

$$V_{CC} = 15V$$
,  $\Theta_{ja} = 250$ °C/W, og  $V_T = 26$ mV

$$R_{E} \geq -K \cdot V_{CC} \cdot \Theta_{ja} - \frac{V_{T}}{I_{C}}$$

$$\geq 2 \frac{mV}{{}^{o}C} \cdot 15V \cdot 250 \frac{{}^{o}C}{W} - \frac{26mV}{3.47mA} = 7.2m\Omega$$

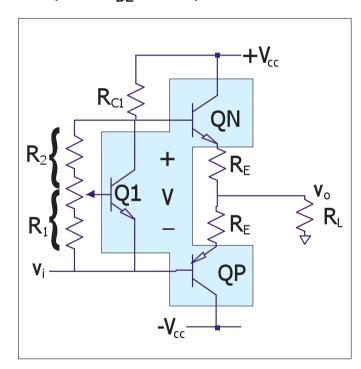
$$R_E \ge 5\Omega@I_{C,\text{max}} = 10mA$$

En utrolig effektiv metode til at opnå termisk stabilitet

### **V**<sub>BE</sub>-Multiplier som termisk stabilisator



- Med R<sub>E</sub> modstandene er der principielt set allerede taget højde for termisk run-away
- Vi kan nu alligevel godt li at gå med både livrem og seler, så kan vi udnytte V<sub>BE</sub>-Multiplieren til at sikre en endnu bedre termisk stabilitet?



$$I_{R2} > I_{B1}$$

$$V \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = V_{BE}$$

$$V = V_{BE,1} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

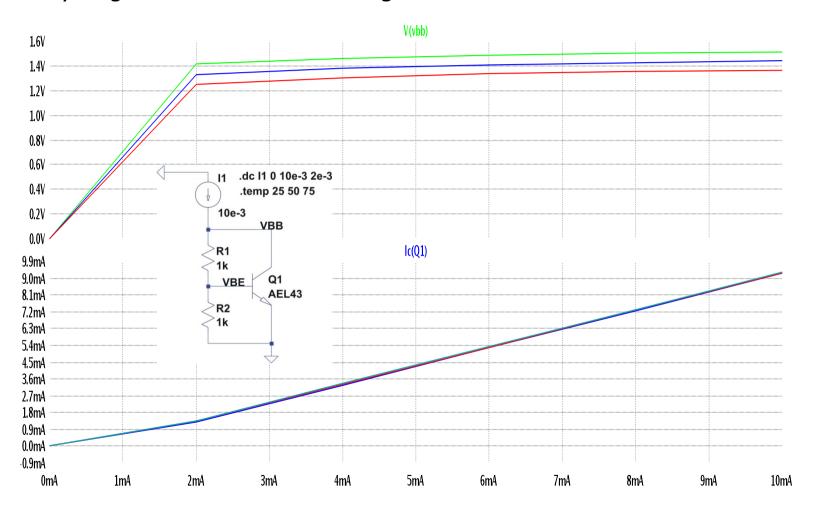
Termisk kobling sikre at  $V_{BE,N}$ ,  $V_{BE,P}$  og  $V_{BE,1}$  følges

Stiger strømmen i QN så  $V_{BE,N}$  falder som følge af en temperatur stigning, så vil en termisk koblet  $V_{BE,1}$  også falde ...

### **V**<sub>BE</sub>-Multiplier som termisk stabilisator



• Sammenhængen mellem temperatur og  $V_{BE}$  for  $V_{BE}$ -multiplieren ses tydeligt når en SPICE simulering køres





10e-3

**VBB** 

Q1

 Når vi regner på V<sub>BE</sub>-Multiplieren må vi gøre os en antagelse om hvor meget af strømmen det løber gennem cross-over transistoren (Q1) og hvor meget der løber i bias modstandene

• Når vi har valgt forholdet mellem strømmene skal vi evt. have lavet en korrektion for  $V_{\text{BE}}$  da denne jo afhænger af  $I_{\text{C}}$ 

$$I_{C,1} = I_S \cdot \exp\left(\frac{v_{BE,1}}{V_T}\right)$$

$$I_{C,2} = I_S \cdot \exp\left(\frac{v_{BE,2}}{V_T}\right)$$

$$V_{BE,2} = v_{BE,1} + V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{C,2}}{I_{C,1}}\right)$$

• Har vi fx. oplyst at  $V_{BE}=0.7V$  for  $I_{C}=1$ mA og vi samtidig antager at der løber 10mA-0.7/1k $\Omega=9.3$ mA i Q1 så får vi

$$v_{BE} = 0.7V + 26mV \cdot \ln\left(\frac{9.3mA}{1mA}\right) = 757.98mV$$

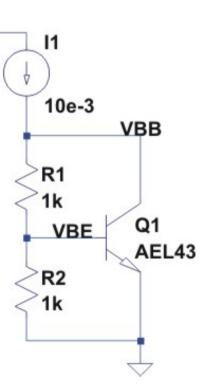


• Antager vi at  $\beta$  er meget stor kan vi se bort fra basis-strømmen i Q1 og strømmen igennem R2 kan beregnes

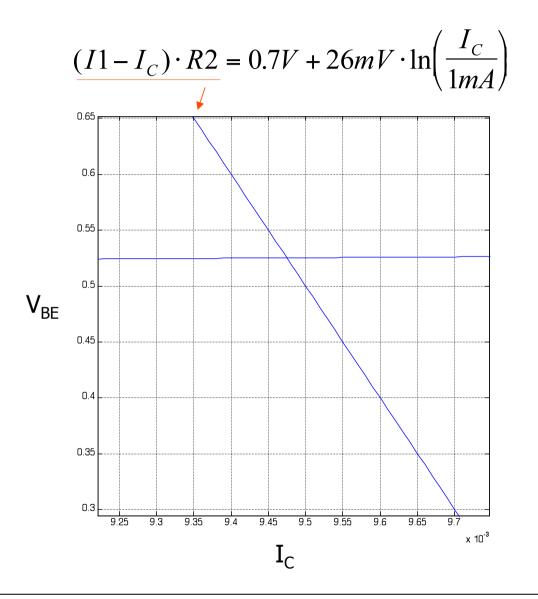
$$I_{R2} = \frac{V_{BE}}{R2} = \frac{757.98mV}{1k\Omega} = 0.757mA$$

- Det er tilstrækkeligt tæt på de 0.7mA vi havde gættet os til
- Hvis ikke det havde været tilfælde skulle vi have været endnu en iteration igennem
- Alternativet er at løse opgaven grafisk ved at løse følgende udtryk for  ${\rm I}_{\rm C}$

$$(I1 - I_C) \cdot R2 = 0.7V + 26mV \cdot \ln\left(\frac{I_C}{1mA}\right)$$

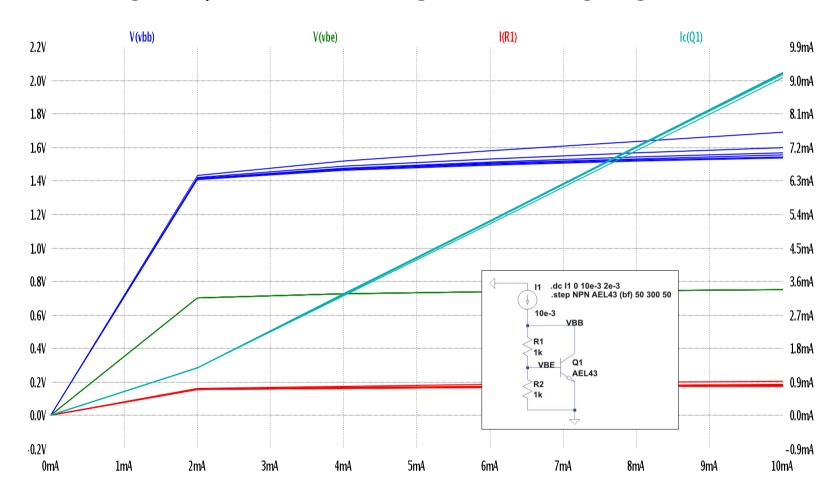








• LTspice kan naturligvis også benyttes til at finde en mere nøjagtig løsning hvor  $\beta$  for transistoren tages med i betragtningerne



### Lidt til opgaverne



#### Opgave 1 og 2

 Beregninger på udgangstrin hvor bla. maksimal junction temperatur skal bestemmes

#### Opgave 3

- Sedra &Smith fra AEL15 (hvis ikke i nåede den sidst .. og det gjorde I ikke)
- Beregninger på en V<sub>BE</sub>-multiplier
- Skip evt. spørgsmål (d) eller nøjes med en SPICE løsning

#### Opgave 4

- o Sedra &Smith fra AEL15 (hvis ikke i nåede den sidst .. og det ☺)
- Beregninger på et klasse AB udgangstrin
- Bestem alle hvilestrømme og de tilhørende basis-emitter spændinger som det første
- Bestem herefter hvilke transistorer der leder når udgangen er høj/lav og lav nye beregninger for strømme og spændinger og se om antagelserne holder stik

#### Opgave 5

 Stor opgave hvor der skal gøres en række overvejelser ang. termisk stabilitet og køling på en klasse AB forstærker